

Erweiterung des Maschinenparks

Bislang waren wir mit unserer Maschinenvielfalt für Kleinmengen bis hin zu Großserien bestens aufgestellt. In der Vergangenheit konnten wir allerdings vermehrt einen erhöhten Bedarf bei mittleren Stückzahlen im IC-Bereich feststellen. Diesem Trend und speziell für dieses Segment haben wir in den vergangenen zwei Jahren mit Investitionen von über einer Million Euro für die Erweiterung unseres Maschinenparks Rechnung getragen.

Erworben wurden in Summe drei Maschinen, wobei wir auch hier unserer von unseren Kunden sehr geschätzten Linie treu geblieben sind: Die Maschinen wurden sozusagen in Vollausstattung beschafft. Das bedeutet, dass die Maschinen sowohl für Tray- als auch für Tube-Ware ausgerüstet sind und selbstverständlich eine vollautomatische optische 2D- und 3D-Inspektion beinhalten. Ein mit vier Z-Achsen bestücktes Pick-and-Place-Portal transferiert die Teile in der Maschine äußerst flexibel und gurtet diese nach der Inspektion dann in das integrierte universelle Gurtungsmodul mit Orientierungskontrolle. Dieser Schritt ermöglicht uns auch in Zukunft, unseren Kunden mit modernster Technologie ausgeführte, hochklassige



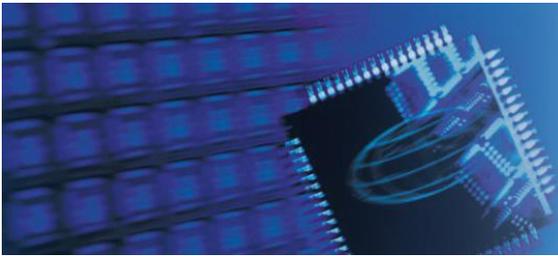
Beispielmaschine / Bild: Plescher

Dienstleistungen in der Mikroelektronik zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen anbieten zu können. Diese Investition stellt also einen bedeutenden Fortschritt in unserer Kapazität und Effizienz dar.

Durch den Einsatz dieser neuen und hochpräzisen Fertigungsanlagen können wir zudem komplexere Komponenten noch schneller und genauer bearbeiten. Damit können wir auch weiterhin auf die stetig wachsenden Anforderungen und innovativen Entwicklungen in der Branche angepasst reagieren.

Die so möglich gewordene Verarbeitung von JEDEC-, 4"- und 2"-Trays beziehungsweise Waffle-Packs gewährt uns außerdem eine genauso große Flexibilität, wie die sehr schnell einrichtbaren Tube-Rüstsätze zum Beispiel für SO 150 mil, SSOP 209 mil, TSSOP 173 mil, MSOP, QFN 04x04, 05x05 und 07x07. Auch im Bereich der 2D- und 3D-Inspektionen lassen die Systeme kaum noch einen Wunsch offen. So sind OCR- und Marking-Prüfungen genauso standardmäßig möglich wie die meist genutzten 3D-Parameter Coplanarity, Standoff, Pitch uvm.

Mit den nun in Betrieb genommenen Systemen haben wir wieder einmal bewiesen, dass der zu Beginn unmöglich erscheinende Spagat zwischen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit doch realisiert werden kann.



Die neuen Maschinen bieten unter anderem folgende Vorteile:

- **Höhere Präzision:** Durch modernste Messtechniken können wir die Qualität unserer Dienstleistungen weiter steigern.
- **Erhöhte Produktkapazität:** Dank verbesserter Prozesse können wir größere Stückzahlen in kürzerer Zeit bearbeiten.
- **Nachhaltigkeit:** Unsere neuen Anlagen sind energieeffizienter und tragen so zu einer umweltfreundlicheren Produktion bei.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Investition nicht nur unsere Position als führender Dienstleister der Elektronikindustrie festigen, sondern auch unseren geschätzten Geschäftspartnern zahlreiche Vorteile bringen wird. Gemeinsam können wir so die technologischen Herausforderungen der Zukunft meistern und innovative Lösungen entwickeln.

S&P Dienstleistungen in der Mikroelektronik GmbH

Willi-Bleicher-Strasse 9
D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon: (+49) 7021/50 98-0

www.sp-mikroelektronik.de
Geschäftsführer:
Gerd Salomonsen , Andreas Plescher

Kontakt:
Telefon: (+49) 7021/50 98-30
vertrieb@sp-mikroelektronik.de
